

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 7 部門第 2 区分

【発行日】平成20年10月16日(2008.10.16)

【公開番号】特開2006-108654(P2006-108654A)

【公開日】平成18年4月20日(2006.4.20)

【年通号数】公開・登録公報2006-016

【出願番号】特願2005-260169(P2005-260169)

【国際特許分類】

H 0 1 L 21/822 (2006.01)

H 0 1 L 27/04 (2006.01)

G 0 6 K 19/077 (2006.01)

G 0 6 K 19/07 (2006.01)

H 0 1 L 29/786 (2006.01)

H 0 1 L 21/8234 (2006.01)

H 0 1 L 27/06 (2006.01)

H 0 1 L 27/08 (2006.01)

H 0 1 L 21/8238 (2006.01)

H 0 1 L 27/092 (2006.01)

H 0 1 L 27/12 (2006.01)

【F I】

H 0 1 L 27/04 C

G 0 6 K 19/00 K

G 0 6 K 19/00 H

H 0 1 L 29/78 6 1 3 Z

H 0 1 L 27/06 1 0 2 A

H 0 1 L 27/08 3 3 1 E

H 0 1 L 27/08 3 2 1 B

H 0 1 L 27/12 L

【手続補正書】

【提出日】平成20年9月3日(2008.9.3)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

ＩＣチップと、前記ＩＣチップと少なくとも一部が重なるように設けられたアンテナと、を有する無線チップであって、
前記ＩＣチップと、前記アンテナと、が絶縁膜を介して重なる位置に、前記ＩＣチップ上に形成された配線を第１の電極とし、前記アンテナを第２の電極とする容量素子が形成されていることを特徴とする無線チップ。

【請求項 2】

請求項 1 において、
前記ＩＣチップは、集積回路と、前記容量素子と、を有し、
前記集積回路は、半導体膜と、前記半導体膜上にゲート絶縁膜を介して形成されたゲート電極と、前記ゲート電極上に形成された第１の絶縁膜と、前記第１の絶縁膜上に形成されたソース電極およびドレイン電極と、を有し、

前記配線は、前記第 1 の絶縁膜上に形成され、かつ、前記ソース電極およびドレイン電極と同じ材料で形成されていることを特徴とする無線チップ。

【請求項 3】

請求項 1 において、

前記 IC チップは、集積回路と、前記容量素子と、を有し、

前記集積回路は、半導体膜と、前記半導体膜上にゲート絶縁膜を介して形成されたゲート電極と、前記ゲート電極上に形成された第 1 の絶縁膜と、前記第 1 の絶縁膜上に形成されたソース電極およびドレイン電極と、を有し、

前記配線は、前記ゲート絶縁膜上に形成され、かつ、前記ゲート電極と同じ材料で形成されていることを特徴とする無線チップ。

【請求項 4】

請求項 1 において、

前記 IC チップは、集積回路と、前記容量素子と、を有し、

前記集積回路は、基板上に形成された半導体膜と、前記半導体膜上にゲート絶縁膜を介して形成されたゲート電極と、前記ゲート電極上に形成された第 1 の絶縁膜と、前記第 1 の絶縁膜上に形成されたソース電極およびドレイン電極と、を有し、

前記配線は、前記基板上に形成され、かつ、前記半導体膜と同じ材料で形成されていることを特徴とする無線チップ。

【請求項 5】

IC チップと、前記 IC チップと少なくとも一部が重なるように設けられたアンテナと、を有する無線チップであって、

前記 IC チップと、前記アンテナと、が絶縁膜を介して重なる位置に、前記 IC チップ上に形成された第 1 の配線を第 1 の電極とし、第 1 の配線上に第 1 の絶縁膜を介して形成された第 2 の配線を第 2 の電極とする第 1 の容量素子と、前記第 2 の配線を第 1 の電極とし、前記第 2 の配線上に第 2 の絶縁膜を介して形成された前記アンテナを第 2 の電極とする第 2 の容量素子が形成されていることを特徴とする無線チップ。

【請求項 6】

請求項 1 乃至請求項 5 のいずれか一項において、

前記 IC チップおよび前記アンテナは、同一基板上に形成されていることを特徴とする無線チップ。